

BAMFIT – Accelerated Mechanical Fatigue Interconnect Test



Bond-Drahtverbindungen, die in großer Stückzahl in Leistungshalbleitermodulen verbaut werden, müssen über mehrere Dekaden und unter hohen thermomechanischen Belastungen zuverlässig halten. Die Optimierung von Bond-Verbindungen wird derzeit mit statischen Pull- und Schertests realisiert. Hinweise auf die Langzeitzuverlässigkeit geben nur zeitaufwendige Lastwechsellasts und Erfahrungswerte. Um diese Lücke zu schließen, wurde hier ein hoch beschleunigtes Prüfverfahren zur Lebensdauerbestimmung von Bond-Drahtverbindungen entwickelt